

電子回路基板生産動向(2003年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m ²)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m ²)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 15年 1月 実績	電子回路基板	1,932	58,838	104.6	93.7	1,932	58,838	104.6	93.7
	リジッドプリント配線板	1,349	36,943	98.8	80.8	1,349	36,943	98.8	80.8
	片面プリント配線板	442	1,914	89.5	87.3	442	1,914	89.5	87.3
	両面プリント配線板	443	8,624	111.0	108.0	443	8,624	111.0	108.0
	多層プリント配線板(4層)	265	8,824	105.2	50.5	265	8,824	105.2	50.5
	多層プリント配線板(6-8層)	97	7,598	69.3	88.0	97	7,598	69.3	88.0
	多層プリント配線板(10層以上)	18	1,986	94.7	84.3	18	1,986	94.7	84.3
	ビルドアップ多層配線板	84	7,997	137.7	112.9	84	7,997	137.7	112.9
	フレキシブルプリント配線板	469	11,555	123.1	144.5	469	11,555	123.1	144.5
	片面フレキシブル配線板	278	5,056	110.8	121.7	278	5,056	110.8	121.7
	両面・多層フレキシブル配線板	191	6,499	148.1	169.1	191	6,499	148.1	169.1
	モジュール基板	114	10,296	106.3	114.3	114	10,296	105.7	113.9
	リジッド系モジュール基板	26	5,912	173.3	128.5	26	5,912	173.3	128.5
その他のモジュール基板	89	4,384	95.5	98.1	89	4,384	95.2	98.7	
その他の電子回路基板	1	44	218.8	133.3	1	44	218.8	133.3	
平成 15年 2月 実績	電子回路基板	1,929	58,801	97.3	91.5	3,861	117,639	100.8	92.5
	リジッドプリント配線板	1,354	37,218	91.0	83.7	2,703	74,161	94.7	82.2
	片面プリント配線板	445	1,918	80.9	79.3	887	3,832	85.0	83.1
	両面プリント配線板	445	8,559	102.5	103.3	888	17,183	106.6	105.6
	多層プリント配線板(4層)	263	9,146	98.5	61.2	528	17,970	101.7	55.4
	多層プリント配線板(6-8層)	97	7,700	64.2	84.9	194	15,298	66.7	86.4
	多層プリント配線板(10層以上)	19	2,147	90.5	81.3	37	4,133	92.5	82.7
	ビルドアップ多層配線板	85	7,748	132.8	108.7	169	15,745	135.2	110.8
	フレキシブルプリント配線板	446	10,903	115.5	131.9	915	22,458	119.3	138.1
	片面フレキシブル配線板	266	4,840	109.5	114.4	544	9,896	110.1	118.0
	両面・多層フレキシブル配線板	180	6,063	125.9	150.2	371	12,562	136.4	159.4
	モジュール基板	128	10,598	109.4	92.4	242	20,894	107.4	101.7
	リジッド系モジュール基板	24	5,550	120.0	81.7	50	11,462	142.9	100.6
その他のモジュール基板	104	5,048	106.5	108.1	193	9,432	100.8	103.8	
その他の電子回路基板	1	82	152.2	117.1	2	126	179.5	122.3	
平成 15年 3月 実績	電子回路基板	2,039	66,794	94.0	87.4	5,900	184,433	98.4	90.6
	リジッドプリント配線板	1,381	38,876	86.5	77.9	4,085	113,037	91.8	80.7
	片面プリント配線板	473	1,923	79.5	76.2	1,361	5,755	83.0	80.7
	両面プリント配線板	429	8,903	93.3	94.9	1,317	26,086	101.9	101.7
	多層プリント配線板(4層)	262	8,525	86.8	46.2	791	26,495	96.3	52.1
	多層プリント配線板(6-8層)	103	8,079	69.6	89.6	297	23,377	67.7	87.5
	多層プリント配線板(10層以上)	19	2,230	86.4	77.9	56	6,363	88.9	81.0
	ビルドアップ多層配線板	95	9,216	139.7	120.3	263	24,961	135.6	114.1
	フレキシブルプリント配線板	499	12,511	115.0	133.5	1,414	34,969	117.7	136.4
	片面フレキシブル配線板	289	5,360	106.6	114.3	833	15,256	108.7	116.7
	両面・多層フレキシブル配線板	210	7,151	129.6	152.8	581	19,713	133.6	157.0
	モジュール基板	157	15,303	106.6	89.2	399	36,197	106.8	95.9
	リジッド系モジュール基板	43	10,248	113.2	88.6	93	21,710	125.7	94.5
その他のモジュール基板	114	5,055	104.8	92.8	307	14,487	102.2	99.9	
その他の電子回路基板	1	104	73.5	89.7	3	230	121.3	105.0	
平成 15年 4月 実績	電子回路基板	1,988	60,264	90.5	87.4	7,888	244,697	96.3	89.8
	リジッドプリント配線板	1,340	39,712	84.0	81.1	5,425	152,749	89.8	80.8
	片面プリント配線板	432	2,031	72.5	79.2	1,793	7,786	80.2	80.3
	両面プリント配線板	425	8,620	89.9	88.0	1,742	34,706	98.6	97.9
	多層プリント配線板(4層)	266	9,916	88.7	54.4	1,057	36,411	94.3	52.7
	多層プリント配線板(6-8層)	110	8,710	81.5	108.3	407	32,087	70.9	92.3
	多層プリント配線板(10層以上)	18	2,348	85.7	85.5	74	8,711	88.1	82.1
	ビルドアップ多層配線板	89	8,087	125.4	106.4	352	33,048	132.8	112.1
	フレキシブルプリント配線板	514	12,502	108.4	123.8	1,928	47,471	115.1	132.8
	片面フレキシブル配線板	294	5,158	98.7	99.8	1,127	20,414	105.9	111.9
	両面・多層フレキシブル配線板	220	7,344	125.0	148.9	801	27,057	131.1	154.7
	モジュール基板	131	7,855	94.5	81.1	530	44,052	103.3	92.8
	リジッド系モジュール基板	16	3,246	76.2	73.9	109	24,956	114.7	91.2
その他のモジュール基板	115	4,609	96.8	85.3	422	19,096	100.6	96.1	
その他の電子回路基板	2	195	267.7	286.8	5	425	155.2	148.1	

電子回路基板生産動向(2003年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 15年 5月 実績	電子回路基板	2,026	63,869	90.0	98.8	9,914	308,566	94.9	91.5
	リジッドプリント配線板	1,401	39,753	86.2	94.6	6,826	192,502	89.0	83.3
	片面プリント配線板	471	2,012	75.8	77.6	2,264	9,798	79.3	79.7
	両面プリント配線板	438	8,793	90.9	90.1	2,180	43,499	97.0	96.2
	多層プリント配線板(4層)	262	10,149	91.6	98.6	1,319	46,560	93.7	58.6
	多層プリント配線板(6-8層)	112	7,943	78.3	90.2	519	40,030	72.4	91.9
	多層プリント配線板(10層以上)	18	2,338	94.7	92.3	92	11,049	89.3	84.1
	ビルドアップ多層配線板	100	8,518	133.3	105.8	452	41,566	132.9	110.8
	フレキシブルプリント配線板	488	12,365	99.8	121.8	2,416	59,836	111.6	130.4
	片面フレキシブル配線板	295	5,301	93.9	102.1	1,422	25,715	103.2	109.7
	両面・多層フレキシブル配線板	192	7,064	109.7	142.4	993	34,121	126.3	152.0
	モジュール基板	136	11,545	92.3	93.1	666	55,597	100.8	92.9
	リジッド系モジュール基板	32	6,956	118.5	101.5	141	31,912	115.6	93.3
	その他のモジュール基板	104	4,589	86.8	82.3	526	23,685	97.4	93.2
その他の電子回路基板	2	206	196.1	223.9	7	631	165.1	166.5	
平成 15年 6月 実績	電子回路基板	2,113	64,801	95.2	100.6	12,027	373,367	94.9	93.0
	リジッドプリント配線板	1,426	40,365	89.8	97.4	8,252	232,867	89.1	85.4
	片面プリント配線板	469	1,989	79.8	83.9	2,733	11,787	79.4	80.4
	両面プリント配線板	462	9,284	94.9	96.3	2,642	52,783	96.6	96.2
	多層プリント配線板(4層)	266	9,269	93.3	91.4	1,585	55,829	93.7	62.3
	多層プリント配線板(6-8層)	117	8,607	83.0	98.0	636	48,637	74.1	92.9
	多層プリント配線板(10層以上)	18	2,501	100.0	110.5	110	13,550	90.9	88.0
	ビルドアップ多層配線板	93	8,715	134.8	105.6	545	50,281	133.3	109.8
	フレキシブルプリント配線板	541	13,135	111.5	130.8	2,957	72,971	111.6	130.5
	片面フレキシブル配線板	323	5,681	108.8	110.0	1,746	31,396	104.2	109.8
	両面・多層フレキシブル配線板	218	7,454	116.0	152.9	1,211	41,575	124.3	152.1
	モジュール基板	144	11,086	91.1	85.8	810	66,683	98.9	91.6
	リジッド系モジュール基板	28	6,076	82.4	85.0	169	37,988	108.3	91.8
	その他のモジュール基板	115	5,010	92.5	86.3	642	28,695	96.6	92.0
その他の電子回路基板	2	215	311.0	346.8	9	846	184.3	191.8	
平成 15年 7月 実績	電子回路基板	2,227	69,762	90.7	101.5	14,254	443,129	94.3	94.2
	リジッドプリント配線板	1,507	42,693	83.4	93.9	9,759	275,560	88.2	86.6
	片面プリント配線板	508	2,128	74.8	79.4	3,241	13,915	78.6	80.2
	両面プリント配線板	475	9,207	88.1	85.9	3,117	61,990	95.2	94.6
	多層プリント配線板(4層)	286	10,506	90.5	92.4	1,871	66,335	93.2	65.7
	多層プリント配線板(6-8層)	119	8,878	66.5	90.6	755	57,515	72.8	92.5
	多層プリント配線板(10層以上)	17	2,559	94.4	118.5	127	16,109	91.4	91.7
	ビルドアップ多層配線板	101	9,415	132.9	107.6	646	59,696	133.2	109.5
	フレキシブルプリント配線板	552	13,569	110.6	120.8	3,509	86,540	111.5	128.8
	片面フレキシブル配線板	334	6,123	103.4	111.1	2,080	37,519	104.1	110.0
	両面・多層フレキシブル配線板	219	7,446	124.4	130.1	1,430	49,021	124.3	148.3
	モジュール基板	166	13,292	102.9	111.5	976	79,975	99.5	94.3
	リジッド系モジュール基板	37	7,774	148.0	125.9	206	45,762	113.8	96.3
	その他のモジュール基板	129	5,518	93.7	94.8	771	34,213	96.1	92.5
その他の電子回路基板	2	208	223.0	270.1	11	1,054	190.3	203.5	
平成 15年 8月 実績	電子回路基板	1,920	60,539	88.7	99.1	16,174	503,668	93.6	94.8
	リジッドプリント配線板	1,284	36,420	79.8	91.7	11,043	311,980	87.1	87.2
	片面プリント配線板	419	1,831	70.2	78.8	3,660	15,746	77.5	80.1
	両面プリント配線板	431	8,279	87.2	86.0	3,548	70,269	94.2	93.5
	多層プリント配線板(4層)	241	8,719	86.7	86.3	2,112	75,054	92.4	67.6
	多層プリント配線板(6-8層)	90	7,030	57.7	82.2	845	64,545	70.8	91.3
	多層プリント配線板(10層以上)	12	2,065	92.3	117.5	139	18,174	91.4	94.1
	ビルドアップ多層配線板	90	8,496	125.0	115.4	736	68,192	132.1	110.2
	フレキシブルプリント配線板	490	12,165	115.6	120.3	3,999	98,705	112.0	127.7
	片面フレキシブル配線板	300	5,440	110.3	114.0	2,380	42,959	104.8	110.5
	両面・多層フレキシブル配線板	190	6,725	125.0	125.9	1,620	55,746	124.4	145.2
	モジュール基板	143	11,789	100.8	105.2	1,119	91,764	99.6	95.6
	リジッド系モジュール基板	31	6,657	114.8	105.1	237	52,419	113.9	97.3
	その他のモジュール基板	112	5,132	97.0	104.8	883	39,345	96.2	94.0
その他の電子回路基板	2	165	371.7	311.3	13	1,219	205.7	213.5	

電子回路基板生産動向(2003年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m ²)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m ²)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 15年 9月 実績	電子回路基板	2,246	71,192	97.8	110.7	18,419	574,860	94.1	96.5
	リジッドプリント配線板	1,505	44,123	86.9	101.5	12,548	356,103	87.1	88.7
	片面プリント配線板	483	2,038	76.2	82.9	4,143	17,784	77.4	80.4
	両面プリント配線板	499	9,698	92.1	87.6	4,046	79,967	93.9	92.7
	多層プリント配線板(4層)	283	10,709	99.0	99.9	2,396	85,763	93.2	70.4
	多層プリント配線板(6-8層)	110	8,753	61.5	94.6	956	73,298	69.7	91.7
	多層プリント配線板(10層以上)	18	2,680	128.6	144.2	158	20,854	95.2	98.5
	ビルドアップ多層配線板	112	10,245	147.4	126.3	848	78,437	134.0	112.0
	フレキシブルプリント配線板	577	14,054	131.1	134.2	4,576	112,759	114.0	128.5
	片面フレキシブル配線板	340	6,046	122.7	125.2	2,720	49,005	106.8	112.1
	両面・多層フレキシブル配線板	236	8,008	143.9	141.9	1,856	63,754	126.6	144.8
	モジュール基板	163	12,870	121.4	125.5	1,282	104,634	101.8	98.4
	リジッド系モジュール基板	35	7,169	145.8	128.4	272	59,588	117.2	100.2
	その他のモジュール基板	128	5,701	115.3	121.0	1,011	45,046	98.3	96.8
その他の電子回路基板	2	145	371.1	273.6	14	1,364	204.1	218.6	
平成 15年 10月 実績	電子回路基板	2,326	72,574	99.6	114.0	20,745	647,434	94.6	98.2
	リジッドプリント配線板	1,572	45,035	89.2	106.8	14,120	401,138	87.3	90.5
	片面プリント配線板	495	2,146	79.2	87.6	4,638	19,930	77.6	81.1
	両面プリント配線板	518	9,708	89.8	94.5	4,564	89,675	93.4	92.9
	多層プリント配線板(4層)	300	10,602	103.8	101.6	2,696	96,365	94.2	72.9
	多層プリント配線板(6-8層)	112	9,005	66.3	101.4	1,068	82,303	69.3	92.7
	多層プリント配線板(10層以上)	19	3,118	126.7	177.6	177	23,972	97.8	104.5
	ビルドアップ多層配線板	129	10,456	148.3	124.6	977	88,893	135.7	113.4
	フレキシブルプリント配線板	578	14,937	125.4	131.2	5,154	127,696	115.2	128.8
	片面フレキシブル配線板	323	5,993	114.9	121.0	3,043	54,998	107.6	113.0
	両面・多層フレキシブル配線板	255	8,944	141.7	138.9	2,111	72,698	128.3	144.0
	モジュール基板	175	12,479	144.3	125.3	1,457	117,113	105.5	100.7
	リジッド系モジュール基板	33	6,645	137.5	126.8	305	66,233	119.1	102.4
	その他のモジュール基板	142	5,834	145.4	122.2	1,153	50,880	102.4	99.2
その他の電子回路基板	1	123	108.0	164.0	15	1,487	192.7	212.7	
平成 15年 11月 実績	電子回路基板	2,173	69,798	97.9	112.1	22,918	717,232	94.9	99.4
	リジッドプリント配線板	1,438	43,226	85.7	104.9	15,558	444,364	87.2	91.7
	片面プリント配線板	441	1,935	75.1	83.0	5,079	21,865	77.4	81.3
	両面プリント配線板	476	9,209	94.3	96.6	5,040	98,884	93.5	93.2
	多層プリント配線板(4層)	272	9,816	92.8	94.8	2,968	106,181	94.1	74.5
	多層プリント配線板(6-8層)	105	8,558	57.1	93.5	1,173	90,861	68.0	92.7
	多層プリント配線板(10層以上)	21	3,290	140.0	198.8	198	27,262	101.0	110.9
	ビルドアップ多層配線板	122	10,418	129.8	127.3	1,099	99,311	135.0	114.7
	フレキシブルプリント配線板	566	14,129	130.7	122.7	5,720	141,825	116.6	128.2
	片面フレキシブル配線板	317	5,398	121.5	109.9	3,360	60,396	108.8	112.7
	両面・多層フレキシブル配線板	249	8,731	143.9	132.2	2,360	81,429	129.7	142.7
	モジュール基板	168	12,347	145.0	131.4	1,625	129,460	108.5	103.0
	リジッド系モジュール基板	35	6,710	166.7	134.9	340	72,943	122.7	104.7
	その他のモジュール基板	133	5,637	141.0	126.2	1,286	56,517	105.3	101.4
その他の電子回路基板	1	96	137.0	147.7	16	1,583	187.9	207.2	
平成 15年 12月 実績	電子回路基板	2,153	69,960	106.5	118.3	25,071	787,192	95.8	100.8
	リジッドプリント配線板	1,388	43,097	94.2	113.0	16,946	487,461	87.7	93.2
	片面プリント配線板	404	1,821	82.6	89.5	5,483	23,686	77.7	81.8
	両面プリント配線板	472	9,631	98.3	101.4	5,512	108,515	93.9	93.9
	多層プリント配線板(4層)	274	9,938	101.9	107.6	3,242	116,119	94.7	76.5
	多層プリント配線板(6-8層)	105	8,759	78.4	117.5	1,278	99,620	68.7	94.5
	多層プリント配線板(10層以上)	21	3,468	140.0	211.1	219	30,730	103.3	117.2
	ビルドアップ多層配線板	112	9,480	130.2	114.7	1,211	108,791	134.6	114.7
	フレキシブルプリント配線板	581	14,322	132.0	123.8	6,301	156,147	117.8	127.8
	片面フレキシブル配線板	330	5,787	123.6	116.2	3,690	66,183	110.0	113.0
	両面・多層フレキシブル配線板	251	8,535	145.9	129.6	2,610	89,964	131.1	141.3
	モジュール基板	183	12,437	156.5	133.1	1,807	141,897	111.9	105.0
	リジッド系モジュール基板	35	6,571	152.2	134.2	375	79,514	125.0	106.6
	その他のモジュール基板	148	5,866	156.9	130.3	1,432	62,383	108.9	103.6
その他の電子回路基板	1	104	202.4	231.1	17	1,687	188.7	208.5	

電子回路基板生産動向(2003年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比	
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)

接続係数について

平成15年1月以降の品目で前年同月比を求める場合は、次の係数を平成14年の数値に乗じて計算して下さい。

	数量	金額
電子回路基板		1.006
モジュール基板	1.089	1.035
その他のモジュール基板	1.110	1.089

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2004/04/16 補正值発表 / 2004/04/23 JPCA作成 / 2004/05/10 訂正)

社団法人日本プリント回路工業会

Japan Printed Circuit Association